



RE460

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Rasterabstände von 0,50 mm bis 1,27 mm
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Adaptionsplatine für 23 verschiedene SMD-IC's
- vorgeätzte Sollbruchstellen zum Trennen einzelner Module von der Platine
- Handlötung: für die SMD-Einzelbearbeitung im Laborbereich ist ein freihändiger Auftrag von 100 bis 200 Einzelpunkten mit präzisen Dosiergeräten bei Rastermaßen von 0,50 mm bis 1,27 mm möglich
- Reflowlötung durch speziell angefertigte separate SMD-Schablonen
- Größe 120 x 175 mm

Modul-Nr.	Pitch	Pin
RE460-01	0,800 mm	QFP 32, 80
	0,500 mm	QFP 64
RE460-02	0,800 mm	QFP 80
	0,650 mm	QFP 100
RE460-03	0,650 mm	QFP 80, 84
RE460-04	0,650 mm	QFP 144, 160
	0,635 mm	QFP 100, 132, 164
RE460-05	1,270 mm	PLCC 32, 52, 68, 84
	0,635 mm	QFP 100
	0,500 mm	QFP 100
RE460-06	1,270 mm	PLCC 28, 44
	0,800 mm	QFP 44
RE460-07	1,270 mm	PLCC 18
RE460-08	1,270 mm	PLCC 20
RE460-09	1,270 mm	PLCC-Eprom 32